




# Del<sup>TM</sup> Studio XPS<sup>TM</sup> 8100:

## Szczegółowe dane techniczne

W tym dokumencie przedstawiono informacje, które mogą być przydatne podczas konfigurowania lub modernizowania komputera oraz aktualizowania sterowników.



**UWAGA:** Oferowane opcje mogą być różne w różnych krajach. Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji komputera, kliknij kolejno **Start**  → **Help and Support** (Pomoc i obsługa techniczna) i wybierz opcję przeglądania informacji o komputerze.

---

### Procesor

---

Typ	Intel <sup>®</sup> Core <sup>™</sup> i7-870 Intel Core i7-860 Intel Core i7-750 Intel Core i5-670 Intel Core i5-661 Intel Core i5-660 Intel Core i5-650 Intel Core i3-540 Intel Core i3-530
Pamięć podręczna L1	32 KB
Pamięć podręczna L2	256 KB na rdzeń

---

**Procesor (ciąg dalszy)**

---

**Pamięć podręczna L3**

Intel Core i5-670	do 4 MB
Intel Core i5-661	
Intel Core i5-660	
Intel Core i5-650	
Intel Core i3-540	
Intel Core i3-530	
Intel Core i7-750	do 6 MB
Intel Core i7-870	do 8 MB
Intel Core i7-860	

---

**Pamięć**

---

Złącza	cztery wewnętrzne złącza DDR3 DIMM
Pojemność	1 GB, 2 GB i 4 GB
Typ pamięci	DDR3 DIMM 1066-MHz lub 1333-MHz; (tylko pamięć bez korekcji błędów ECC)
Obsługiwane konfiguracje pamięci	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB i 16 GB (64-bitowe systemy operacyjne)

---

**Informacje o komputerze**

---

Systemowy zestaw układów	Intel H57
Przepustowość magistrali danych	2,5 GT/s
Przepustowość magistrali DRAM	64 bity
Przepustowość szyny adresowej procesora	64 bity
Obsługa macierzy RAID (tylko wewnętrzne napędy SATA)	RAID 0 (przeplot) RAID 1 (zapis lustrzany)
Układ scalony BIOS (NVRAM)	8 MB
Szybkość pamięci	1333 MHz

---

## Napędy i urządzenia

---

Dostępne z zewnątrz	<ul style="list-style-type: none"><li>• dwie wnęki 5,25 cala na napęd hybrydowy SATA DVD+/-RW Super Multi Drive lub Blu-ray Disc™ albo napęd Blu-ray Disc RW</li></ul>
Dostępne od wewnątrz	dwie wnęki na dyski twarde SATA 3,5 cala
Sieć bezprzewodowa (opcjonalna)	WiFi/Bluetooth®

---

## Magistrala rozszerzeń

---

PCI Express	<ul style="list-style-type: none"><li>• dwukierunkowe złącze Gen2 x1 — 500 MB/s</li><li>• dwukierunkowe złącze Gen2 x16 — 16 GB/s</li></ul>
PCI	szybkość złącza 32-bitowego — 33 MHz
SATA 2.0	1,5 Gb/s i 3,0 Gb/s
USB 2.0	<ul style="list-style-type: none"><li>• tryb high speed — 480 Mb/s</li><li>• tryb full speed — 12 Mb/s</li><li>• tryb low speed — 1,2 Mb/s</li></ul>

---

## Czytnik kart pamięci

---

Obsługiwane karty	<ul style="list-style-type: none"><li>• CompactFlash (CF)</li><li>• Smart Media (SM)</li><li>• xD-Picture (xD)</li><li>• Memory Stick (MS)</li><li>• Memory Stick Duo</li><li>• Memory Stick PRO Duo</li><li>• Memory Stick PRO (MSPRO)</li><li>• Memory Stick PRO HG (MSPRO HG)</li><li>• SecureDigital (SD)</li><li>• SecureDigital Card (SDHC) 2.0</li><li>• MultiMedia Card (MMC)</li><li>• MicroDrive (MD)</li></ul>
-------------------	---

---

## Grafika

---

Zintegrowana	Intel <sup>®</sup> Graphics Media Accelerator HD
Autonomiczna	karta PCI Express x16

---

## Dźwięk

---

Typ	Zintegrowana karta dźwiękowa z obsługą dźwięku dookólnego 7.1 wysokiej jakości, S/PDIF
-----	--

---

## Złącza na płycie systemowej

---

Pamięć	cztery złącza 240-stykowe
PCI	jedno złącze 124-stykowe
PCI Express x1	dwa złącza 36-stykowe
PCI Express x16	jedno złącze 164-stykowe
Zasilanie (płyta systemowa)	jedno 24-stykowe złącze EPS 12 V (zgodne ze standardem ATX)
Wentylator procesora	jedno złącze 4-stykowe

---

**Złącza na płycie systemowej (ciąg dalszy)**

---

Wentylator obudowy	jedno złącze 3-stykowe
Przednie złącze USB	pięć złączy 9-stykowych
Przednie złącze audio	jedno złącze 9-stykowe do obsługi dwukanałowego dźwięku stereo i mikrofonu
SATA	cztery złącza 7-stykowe
Wyjście S/PDIF	jedno złącze 5-stykowe

---

**Złącza zewnętrzne**

---

Karta sieciowa	złącze RJ45
USB	złącza USB 2.0: dwa na panelu górnym, dwa na panelu przednim i cztery na panelu tylnym
Dźwięk	panel górny — jedno złącze słuchawek i jedno złącze mikrofonu panel tylny — sześć złączy do obsługi dźwięku 7.1
S/PDIF	jedno złącze S/PDIF (optyczne)
eSATA	jedno złącze na panelu tylnym
IEEE 1394a	jedno 6-stykowe złącze szeregowo na panelu tylnym
Interfejs HDMI	złącze 19-stykowe
DVI	złącze 24-stykowe

---

**Gniazda rozszerzeń**

---

PCI	
Złącza	jedno
Rozmiar złącza	złącze 124-stykowe
Przepustowość danych złącza (maksymalna)	32 bity

---

**Gniazda rozszerzeń (ciąg dalszy)**

---

## PCI Express x1

Złącza	dwa
Rozmiar złącza	Złącze 36-stykowe
Przepustowość danych złącza (maksymalna)	1 tor dla PCI Express

## PCI Express x16

Złącza	jedno
Rozmiar złącza	złącze 164-stykowe
Przepustowość danych złącza (maksymalna)	16 tor dla PCI Express

---

**Zasilanie**

---

## Zasilacz prądu stałego

Moc	350 W
Maksymalne rozproszenie ciepła	1836 BTU/godz.

**UWAGA:** Rozproszenie ciepła jest obliczane na podstawie znamionowej mocy zasilania w watach.

Napięcie wejściowe	Prąd przemienny 115/230 V
Częstotliwość prądu wejściowego	50/60 Hz
Znamionowy prąd wyjściowy	8 A/4 A

---

**Bateria**

---

Bateria pastylkowa	litowa bateria pastylkowa 3 V CR2032
--------------------	--------------------------------------

---

**Wymiary i masa**

---

Wysokość	407,75 mm (16,02 cala)
Szerokość	185,81 mm (7,31 cala)
Głębokość	454,67 mm (17,90 cala)
Masa	10,18 kg (22,40 funta)

---

## Środowisko pracy komputera

---

Zakres temperatur:

Podczas pracy	10° C do 35° C (50° F do 95° F)
Podczas przechowywania	-40° C do 65° C (-40° F do 149° F)

Wilgotność względna 20% do 80% (bez kondensacji)

Maksymalne drgania (z zastosowaniem spektrum losowych wibracji, które symulują środowisko użytkownika):

Podczas pracy	0,25 GRMS
Podczas przechowywania	2,2 GRMS

Maksymalny wstrząs (mierzony dla dysku twardego z zaparkowanymi głowicami i impulsu pół-sinusoidalnego o długości 2 ms):

Podczas pracy	Impuls półsinusoidalny: 40 G przez 2 ms przy przyspieszeniu 20 cali/s (51 cm/s)
Podczas przechowywania	Impuls półsinusoidalny: 50 G przez 26 ms przy przyspieszeniu 320 cali/s (813 cm/s)

Wysokość nad poziomem morza (maksymalna):

Podczas pracy	-15,2 do 3048 m (-50 do 10 000 stóp)
Podczas przechowywania	-15,2 do 10 668 m (-50 do 35 000 stóp)

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu G2 lub niższy wg standardu ISA-S71.04-1985

---

**Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.**

**© 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w tekście: *Dell*, logo *DELL* i *Studio XPS* są znakami towarowymi firmy Dell Inc.; *Intel* jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a *Core* jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach; *Microsoft*, *Windows* i logo przycisku Start systemu *Windows* są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż jej własne.

**Model: D03M series**

**Typ: D03M001**

**Październik 2009**

**Wersja A00**